

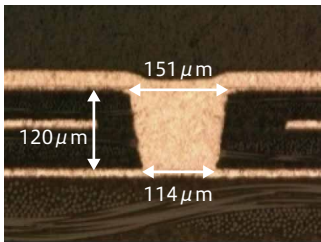
海外開発センター

海外開発センター開発事例

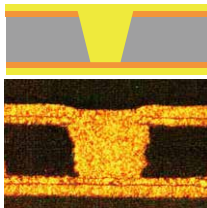
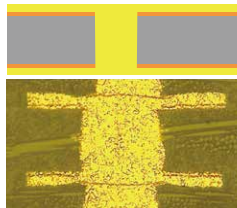
Overseas Development Center

基板産業の一大集積地である中国において、先進的な技術を全社展開する開発組織を武漢工場に設置。

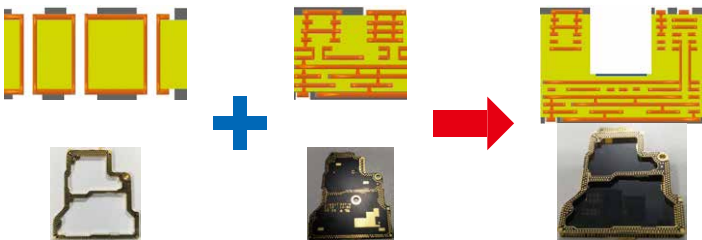
開発技術

高密度				
スキップビア	穴径Φ0.15mm, 層間厚0.12mm	LVHダイレクト銅貫通加工： メッキ埋め処理実施 凹み量max30μm		量産中

L1からL3への層間接続のためのレーザービアを形成

高信頼性				
Core層LTHF	LVH径Φ85μm 層間厚64μm Max LVH径Φ115μm 層間厚200μm	一般的なコア層LVH 	コア層LTHF 	量産中

AnyLayerコア層LVHの信頼性を向上 (Laser Through Hole Filled)

複合化				
キャビティ	2層インターポーザ基板 + AnyLayer、HDI基板			量産中

キャビティ構造により信号基板とインターポーザを一体化

高速信号				
バックドリル	ビアスタブ 100μm+/-75μm			量産中

ビアスタブの除去により高周波信号に対応